임베디드 시스템

2019년 2학기 오승민 (smoh@kongju.ac.kr)

임베디드 시스템

하드웨어

목차

- 1. 임베디드 하드웨어
- 2. 용어 소개
- 3. 논리 게이트

- ▶ 임베디드 시스템에서의 하드웨어
 - 프로세서: 우리 인간의 뇌
 - 메모리: 데이터를 저장할 수 있는 기억공간
 - 입력장치: 입력데이터
 - 출력장치: 프로세서로부터 가공된 데이터 출력
 - 네트워크 지원: 원거리에서도 활용 가능
 - 다만! 범용PC처럼 다기능은 아니므로 고성능일 필요 X

▶ PC와 임베디드 시스템에서의 하드웨어 비교

〈표 2-1〉 PC와 임베디드 시스템에서의 하드웨어 비교

HW 항목	PC	임베디드 시스템
프로세서	고성능 탑재	최소한의 성능 탑재
메모리	대용량 메모리	최소한의 메모리 사용
보조기억장치	다양함 (HDD, ODD, DVD)	거의 사용 안 함 또는 플래시 메모리
주변 장치	다양함 (KBD, MOUSE, SPKR)	필요한 장치만 사용

▶ CISC와 RISC의 차이점

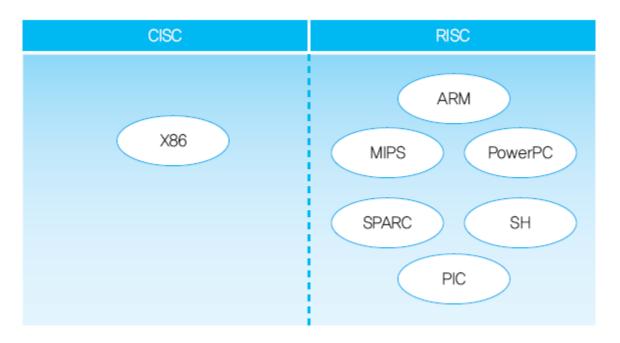
CISC: Complex Instruction Set Computer

RISC: Reduced Instruction Set Computer

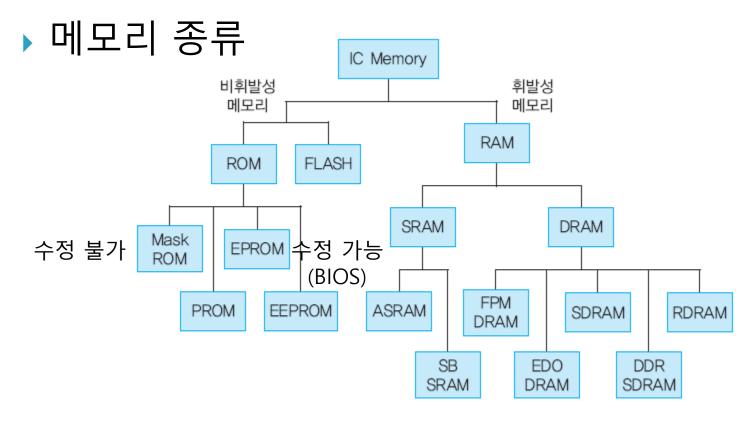
(표 2-2) CISC와 RISC의 차이점

구 분	CISC	RISC
전력소모	많다.	적다
처리속도	느리다.	빠르다
명령어 형식	가변적	고정적
명령어의종류	많다. (300~400개)	적다. (50~60개)
프로그래밍	간단하다	복잡하다
설계및생산	복잡하다	간단하다

▶ 임베디드 프로세서 종류



[그림 2-1] 임베디드 프로세서 종류



[그림 2-2] 메모리 종류

- ▶ ROM의 특징
 - 마이크로 프로세서는 ROM에 새로운 데이터를 저장할 수 없다.
 - 데이터는 변경될 수 없다.
 - 전원이 꺼져도 ROM 데이터는 기억된다.

- ▶ RAM의 특성
 - 마이크로프로세서는 ROM보다 빠르게 RAM으로부터 데이터를 읽을 수 있다.
 - 마이크로프로세서는 빠르게 데이터를 지울 수도 있고,새로운 데이터도 쓸 수 있다.
 - RAM은 전원이 나가는 순간 모든 데이터를 잃어버린다.

▶ SRAM과 DRAM의 비교

〈표 2-3〉 SRAM과 DRAM의 비교

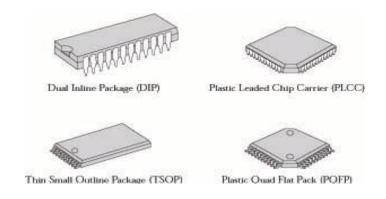
구 분	SRAM	DRAM		
구성요소	Flip-Flop 논리 게이트	Capacitor		
전기공급 방식	지속적 재충전	주기적 전기 공급		
공통점	휘발성			
다른 특징	DRAM보다 빠르지만 비쌈	더 간단하고, 크기가 작음 밀도가 높음 재충전 회로의 지원이 필요 대용량 기억장치에 주로 사용		

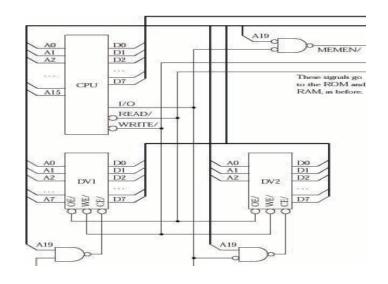
캐시 메모리용

주기억장치용

2.2 용어 소개

- ▶ 칩: 회로가 포함되어 있는 반 도체 부품
- ▶ PCB 기판(Printed Circuit Board): 칩과 칩을 연결하는 구리선으로 구성하는 기판
- 회로도: 부품들의 연결을 그 림으로 그려놓은 것
- ▶ GND/VCC, High/Low: 0볼 트 혹은 5볼트
- Low Enable/Low Active:Low 전압에서 작동하는 신호





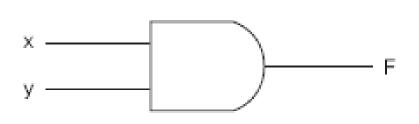
2.2 용어 소개

- ▶ 출력 단자
- ▶ 입력 단자
- ▶ Floating: 어떤 신호 선의 전압을 조정해서 원하는 값으로 만드는 것
- 버스 쟁탈: 두 칩이 하나의 신호선을 구동할 때, 다른 신호를 만들면 칩이 파괴되는 현상

2.3 논리 게이트

▶ AND 게이트

논리 게이트 (Logic Gage)는 여러 트랜지스터로 이루어진 디지털 하드웨어

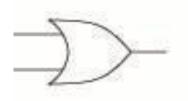


ху	F
0 0	0
0 1	0
10	0
1 1	1

입력이 모두 1일 때 출력이 1

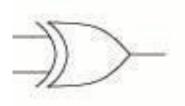
2.3 논리 게이트

▶ OR, XOR 게이트



Input 1	Input 2	Output		
High	High	High		
High	Low	High		
Low	High	High		
Low	Low	Low		

입력 중 하나라도 1이면 출력이 1

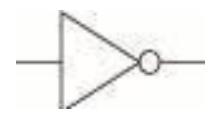


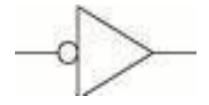
Input 1	Input 2	Output		
High	High	Low		
High	Low	High		
Low	High	High		
Low	Low	Low		

1이 홀수 개의 입력이면 출력이 1

2.3 논리 게이트

▶ 인버터





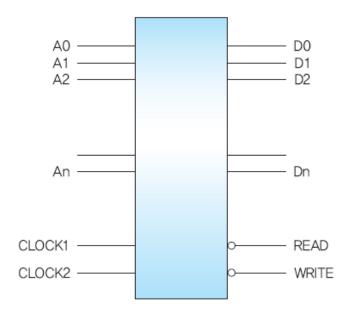
마이크로 프로세서

목차

- ▶마이크로 프로세서
- DMA (Direct Memory Access)
- ▶마이크로 프로세서에 내장된 것들
- ▶마이크로 프로세서에서 사용하는 언어

마이크로프로세서

- 마이크로프로세서가 가지고 있는 신호들
 - 회로의 다른 모든 칩에 읽고 쓸 수 있도록 하는 어 드레스를 나타내는 어드레스 신호 들의 묶음
 - 회로의 다른 모든 칩에 데이터를 보내거나 읽을 수있도록 하는 데이터 신호 들의 묶음
 - 데이터를 읽고 싶을 때 Low로 만드는 READ/ 신호 선과, 쓰고 싶을 때 Low로 만드는 WRITE/ 신호 선
 - 마이크로프로세서가 하는 일의 속도를 조정해서, 결국 시스템의 다른 부분과 맞추는 역할을 하는 클 럭 입력



[그림 3-1] 간단한 마이크로프로세서

마이크로프로세서

▶ 간단한 마이크로 프로세서 시스템

◦ 데이터선: D0 ~ D7

◦ 64K의 메모리 어드레스

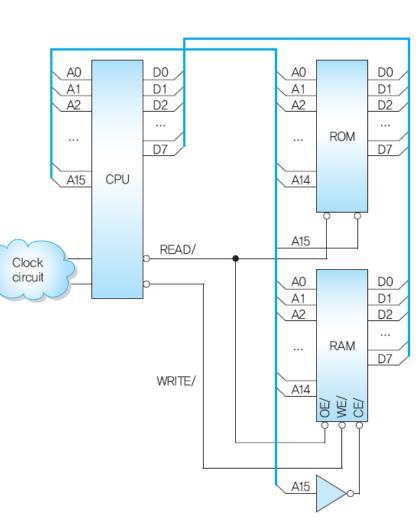
• A0 ~ A15: 16개의데이터 신호 선 → 216~

= 64K

• 타이밍 문제

• Address 선: 안정된 값 유지

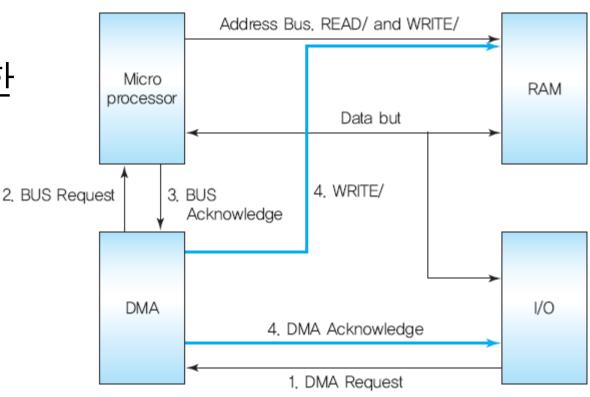
· CE (chip enable) / READ선 활성화



- ▶ DMA의 정의
 - 소프트웨어의 도움이나 추가적인 자원 사용 없이, 시리얼
 포트나 네트워크 같은 I/O 장치에서 데이터를 읽어서 메모
 리에 직접 쓰거나, 메모리에서 읽어서 I/O 장치에 직접 쓰게 해주는 회로 장치

▶ DMA를 사용한

시스템 구조



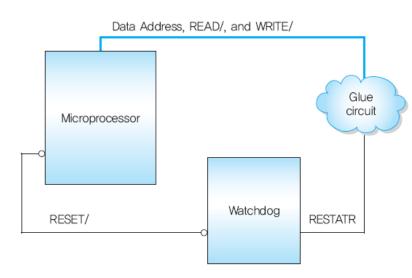
[그림 3-3] DMA를 사용한 시스템 구조

- ▶ DMA의 장점
 - 메모리 직접 접근: 각종 주변 장치에서 접근 가능
 - ◦성능 향상: CPU가 I/O 장치와의 데이터 전송에 관여하지 않아도 됨.
 - 효율성: 결과적으로 한번의 인터럽트만 발생함.

- ▶ DMA의 단점
 - 회로의 복잡도 증가: 추가적인 구현
 - 버스의 과부하: DMA를 거쳐서 데이터가 전송되기 때문에 2번의 버스 사용
 - DMA 채널 필요: I/O별로 각각의 DMA 채널

마이크로 프로세서에 내장된 것들

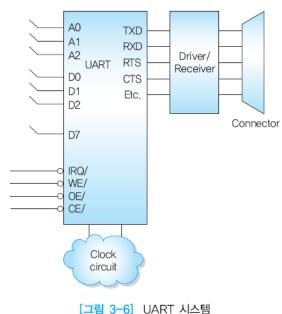
- ▶ 주변 기기
 - 타이머: 마이크로프로세서의 클럭 사이클을 세는 역할
 - 워치독 타이머: 오작동에서 벗어나게 하는 역할
 - ∘ I/O 핀
 - 어드레스 디코딩



[그림 3-5] 워치독 타이머

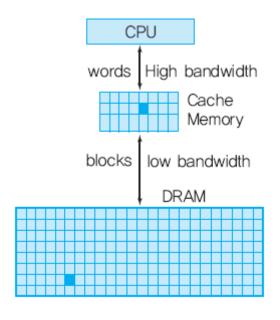
마이크로 프로세서에 내장된 것들

- ▶ 인터페이스
 - UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter): 人 리얼 인터페이스로부터 얻어진 데이터를 변환, 혹은 전 송 (바이트 데이터를 순차적인 비트로 변경)
 - PLD (Programmable Logic Device)



마이크로 프로세서에 내장된 것들

- ▶ 기타 장치
 - 메모리 캐시



속도(read, write access time)

Register

CPU REGISTER

Static RAM

캐쉬 메모리(cache memory)

Dynamic RAM

주기억장치(main memory)

HDD, FDD

magnetic tape

비트당
가격

[그림 3-8] 캐시 메모리

[그림 3-9] 메모리 종류

마이크로프로세서에서 사용하는 언어

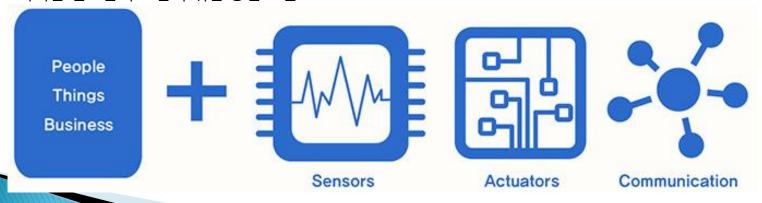
- 어셈블리 언어: 기계어와 어셈블러
- ▶레지스터
 - 범용 레지스터: R1, R2, R3... 계산할 값 저장
 - 특수 레지스터:
 - PC (Program Counter, Program Register): 다음 명령어의
 주소 (혹은 IP, Instruction Pointer)
 - SP (Stack Pointer): 스택의 최상위 주소

디바이스 및 센서

- 디바이스는 장치 또는 기기라 부르는데, 인터넷을 통해 연결되고 칩 셋과 모듈을 이용해 통신이 가능한 하나의 기기로 만들어진 형태를 의미
- 디바이스에는 상황을 인지할 수 있는 센서와 간단한 기능을 수행하는 경량 소프트웨어 내장

▶ 디바이스 구성:

- ✓ 사물 주변 환경 정보를 전기적 신호로 바꿔주는 센서
- ✓ 전기적 신호를 물리적 변화로 바꿔주는 actuator(구동기)
- ✓ 이러한 신호를 주고받기 위한 통신 모듈



디바이스 범위:

- ✓ 디바이스는 일상생활에서 존재하는 모든 기기가 대상
- ✓ 스마트폰, 스마트 시계 같은 웨어러블 기기, TV·냉장고와 같은 가전제품, 조명기기(전구 등), 헬스기기, IP 카메라 및 차량에 장착하는 하이패스 등이 디바이스 종류에 포함

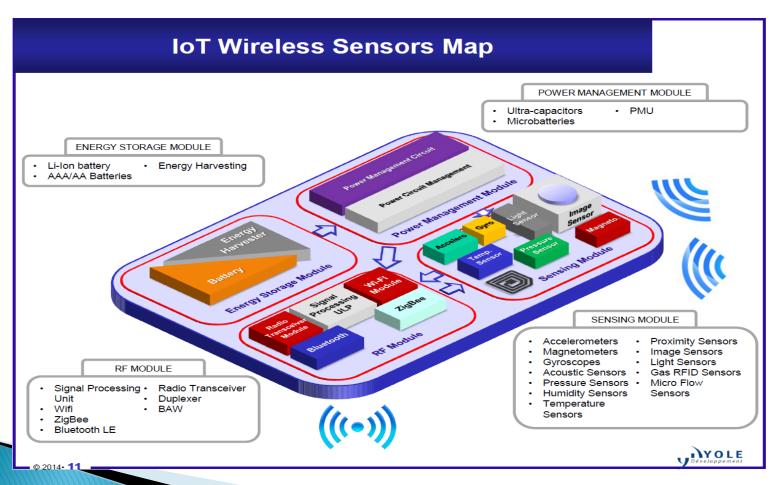
디바이스 주요 역할:

✓ 주위 상황을 감지한 후 데이터로 변형하여 해당 서비스를 제공하기위해 네트워크를 통하여 클라우드 서버 등으로 전송

자율형 디바이스:

- ✓ 사물인터넷의 중요한 요소
- ✓ 사물의 주변 환경을 감지하여 유·무선 통신, 자동 접속, 상호 연동,
 자율 판단·행동을 통해 실감·지능·융합형 서비스를 제공할 수 있는
 는 스마트센서와 디바이스를 의미

▶ 디바이스에 탑재된 센서 Map



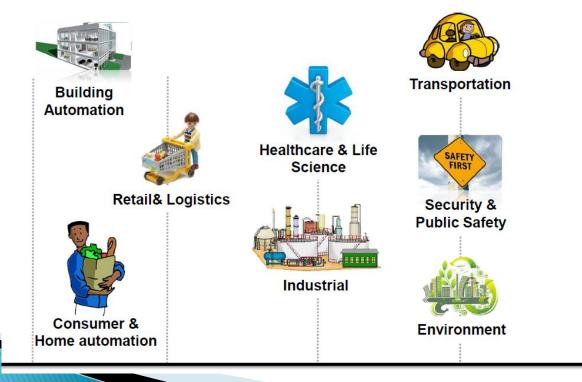
센서의 정의, 활용 분야 및 특징

- ✓ 이미지, 동작, 소리, 빛, 열, 가스, 온도, 습도 등 주변의 물리·화학
 ·생물학적 정보를 감지하여 전기적 신호로 변환하는 모든 장치를
 의미하는 센서는 사물인터넷 디바이스의 핵심
- ✓ 디바이스 용도에 따라 각기 다른 센서들이 디바이스에 내장되어 필요한 데이터를 센싱•수집 하고 이를 신호 처리하여 인터페이스 를 통해 전달하는 기능 수행

▶ 센서의 정의, 활용 분야 및 특징

- ✓ 최근에는 미세전자제어기술(MEMS), 여러 반도체 부품이 하나로 집적되는 반도체 SoC (System on Chip) 기술, 임베디드 소프트 웨어 기술 발전으로 과거보다 지능화된 스마트 센서가 널리 활용
- ✓ 스마트 센서는 마이크로 센서 기술과 반도체 기술을 결합하여 우수한 데이터 처리 능력, 판단 기능, 메모리 기능, 통신 기능 등을 보유한 IoT 기기의 핵심 요소이며, 기존 활용 범위를 넘어 스마트홈, 의료 및 건강, 가전, 환경 등 다양한 분야에 활용
- ✓ 센서의 중요한 요소는 저가격(Lower Cost), 저전력(Lower Power) → 소형(Smaller) 및 무선연결성(Wireless Connectivity)

- ▶ 14.2.1 디바이스별 센서 용도 및 시장 규모
 - 센서가 탑재된 디바이스나 시설은 헬스케어, 제조, 유통·물류, 빌딩, 홈, 자동차 및 환경 등 다양한 분야에 적용



- 전 세계 센서 시장 규모

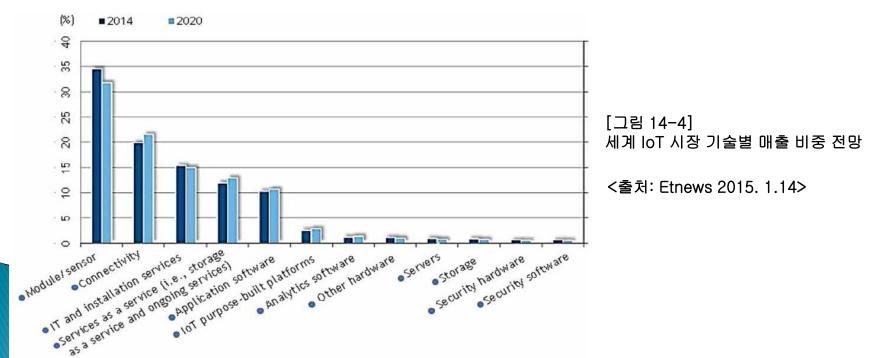
- 2011년 720억 \$에서 2020년 1,410억 \$로 두 배 가량 증가 예상
- 연평균성장률(CAGR: Compound Annual Growth Rate)은 9.4% 전망

구 분	2010	2011	2012	2013	2015	2017	2020	CAGR
스마트폰	7,606	10,932	13,279	15,310	18,158	21,209	27,899	15.8%
자동차	41,756	44,610	47,923	53,134	62,643	71,104	81,096	7.9%
기 타	14,808	16,662	18,360	20,553	24,240	27,639	32,698	9.4%
합계	64,172	72,204	79,562	88,997	105,041	119,952	141,693	9.4%

<출처: Etnews 2015. 1.14>

▶ 전 세계 센서 매출 규모

- ✓ 주요 센서 성장 시장은 자동차 (Automotive), 소비제품 (Consumer Products) 및 메디컬 헬스케어 (Medical Healthcare) 분야 등
- ✓IDC는 센서와 모듈 관련 기술 분야 매출이 IoT 전체 매출의 30% 이상 차지할 것으로 전망

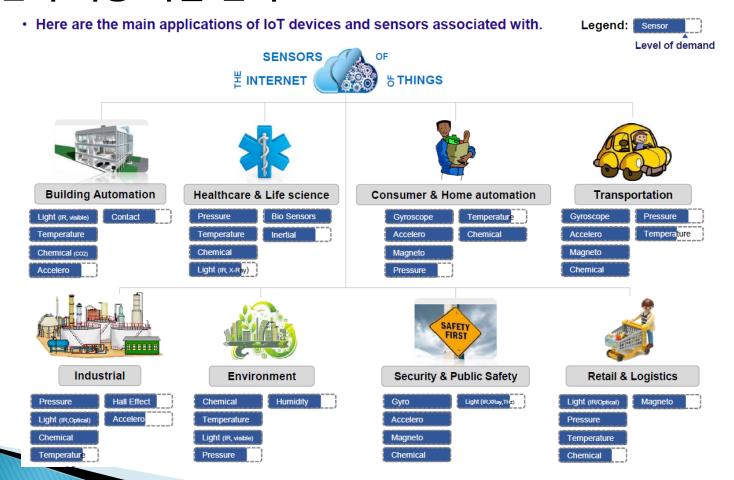


- 디바이스 및 시설별 탑재 센서 유형

	센서 유형								
구 분	관성 센서	자기 센서	압력 센서	온도 센서	음향 센서	화학 센서	습도 센서	질량유 량센서	기타 센서
자동차	0	0	0	0		0	0	0	0
도시(환경관리)				0	0	0	0		0
온도조절장치			0				0		0
완구	0	0	0						
흡연/탄소센서 (소비자용)				0		0	0	0	0
헬스케어 모니터링 (소비자용)	0	0	0	0		0	0		
스마트워치	0	0							0
스마트의류	0	0	0	0	0		0		0
스마트전자소켓 / 어댑터		0		0			0		0

<출처: 가트너, 2014.11>

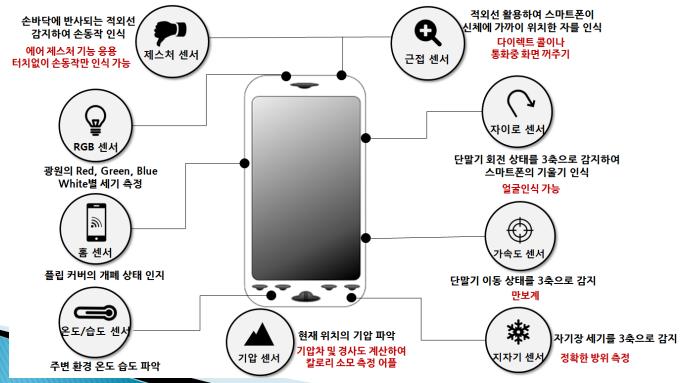
▶ 센서 적용 기술 분야



[그림 14-5] 센서 적용 기술 분야 <출처: Yole Developpement, 2014>

스마트폰에 탑재된 각종 센서

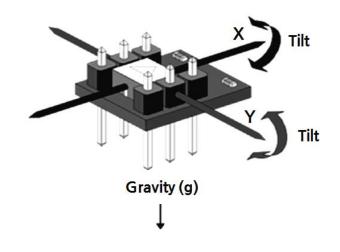
✓ 스마트폰에는 온습도, 지자기, 자이로, 가속도 센서 등 9가지 다양 한 센서가 내장 되어 사람들에게 편리한 기능 제공



[그림 14-6] 스마트폰에 탑재된 각종 센서

- 동작인식 센서란?

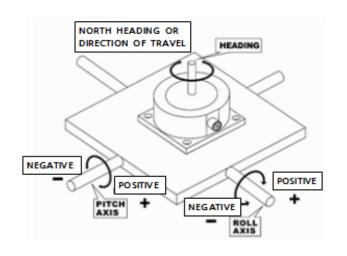
- ✓ 단위 시간당 직선운동 속도 변화를 측정하는 가속도 센서(acceleration sensor)
- ✓ 가속도 센서가 생성한 값 중 중력가속도를 제외한 3차원 벡터 값을 제공하는 선형 가속 도 센서(linear acceleration sensor)
- ✓ 중력이 어느 방향으로 작용하는지를 탐지하 는 중력 센서(gravity sensor)
- ✓ 한 축 또는 여러 축 회전 움직임의 각 변화 량(각속도)을 측정하는 자이로 센서 (gyroscope sensor)
- ✓ 각(angle)과 축(axis)의 조합을 통해 디바이스 방향을 표기해주는 회전벡터 센서(rotation vector sensor) 등



[그림 14-7] 가속도 센서

• 위치 센서란?

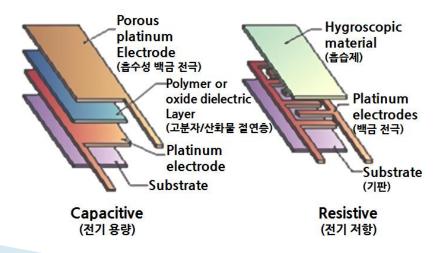
- ✓ 절대적인 위치와 시간 정보를 제공해 주는 위성기반 항법 시스템인 GPS (global positioning system)
- ✓ 지자계를 이용한 절대적 방향 측정과 내 비게이션 지도의 정확한 방향 표식에 사 용되는 지자계 센서 (terrestrial magnetism sensor)
- ✓ x, y, z 3축 상에서 변화하는 회전각을 측정하는 방향 센서(orientation sensor)
- ✓ 디바이스에서 측정 대상까지의 근접도를 측정하는 근접 센서(proximity sensor) 등



[그림 14-8] 지자계 센서

• 환경 센서란?

- ✓ 스마트 디바이스 내부 또는 디바이스 주변 온도 측정에 사용되는 온도 센서 (ambient temperature sensor)
- ✓ 공기 중의 수분량 양이나 비율을 측정하여 백분율로 환산해 주는 습도 센서 (humidity sensor)
- ✓ 디바이스 주변의 밝기를 측정하는데 이용하는 조도 센서 (illumination sensor)
- ✓ 대기압(air pressure)을 측정하는 기압 센서 (pressure sensor) 등



- 기타 센서들은 어떤 것들이 있을까요?
 - 인텔의 리얼센스(Realsense):
 - 3D 촬영이 가능한 이미지 센서로서 2차원 평면 이미지만을 인식하는 다른 이미지센서들과 달리 이미지 깊이까지 인식
 - 이 기술은 영화 마이너리티 리포트나 아바타에서 허공에 손을 대고 화면을 이동시키거나 스크롤하는 동작인식 분야에 활용



[그림 14-10] 인텔의 리얼센스(Realsense)

- ▶ 기타 센서들은 어떤 것들이 있을까요?
 - BCI(Brain Computer Interface):
 - 사람의 뇌파 종류와 패턴을 측정하여 사람의 의도를 파악하는 센싱 기술
 - 뉴로스카이(NeuroSky) 마인드웨이브(MindWave)는 뇌파를 측정하여 생성된 제어신호를 퍼즐박스(Puzzlebox) 오빗(Orbit)이라는 헬리콥터 조정에 이용



[그림 14-11] BCI(Brain Computer Interface)